## 上海硅产业集团股份有限公司

## 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书(草案)(上会稿)修订说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海硅产业集团股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付 现金方式购买上海新昇晶投半导体科技有限公司、上海新昇晶科半导体科技有限 公司、上海新昇晶睿半导体科技有限公司的少数股权,并募集配套资金(以下简 称"本次交易")。

公司于2025年9月4日收到上海证券交易所出具的《关于上海硅产业集团 股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的审核中心意见落 实函》(上证科审(并购重组)〔2025〕32号)(以下简称"《审核中心意见落实 函》")。根据《审核中心意见落实函》及上海证券交易所审核意见的要求,公 司于2025年9月6日披露了《上海硅产业集团股份有限公司发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(上会稿)》(以下简称"草 案(上会稿)")等文件,具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 的相关文件。

相较公司于 2025 年 8 月 29 日披露的《上海硅产业集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》, 草案(上会稿)对部分内容进行了修订,主要修订情况如下:

重组报告书主要章节	修订说明
重大风险提示	更新了与标的资产相关的风险部分内容
第六节 标的资产的评估及作价情况	新增标的资产市场法评估结果的计算过程
第十二节 风险因素	更新了与标的资产相关的风险部分内容

除上述补充和修订之外,因本次交易的交易对方企业名称由"上海上国投资

产管理有限公司"变更为"上海国际集团投资有限公司",公司对重组报告书全文进行了梳理和自查,调整了该交易对方相关表述,并完善了其他少许表述,对本次交易方案无影响。

特此公告。

上海硅产业集团股份有限公司董事会 2025年9月6日